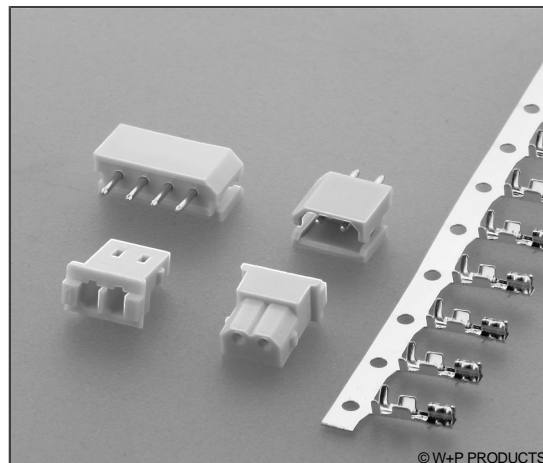


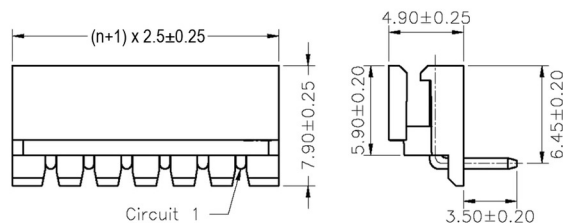
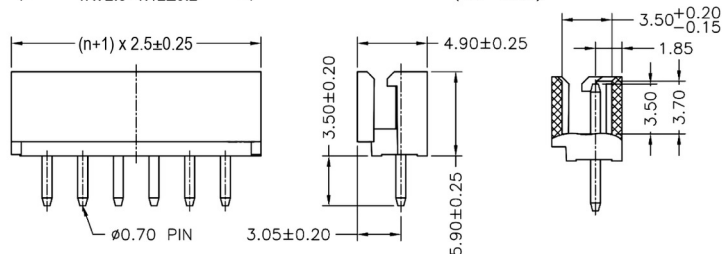
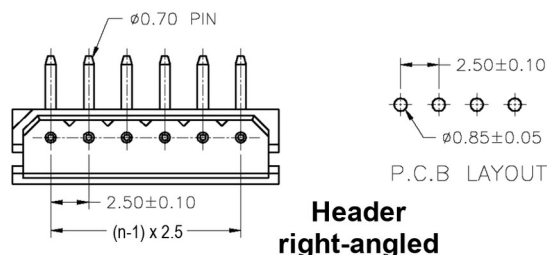
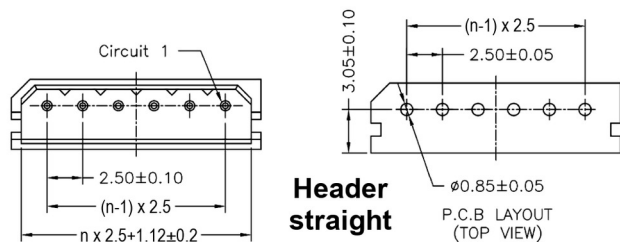
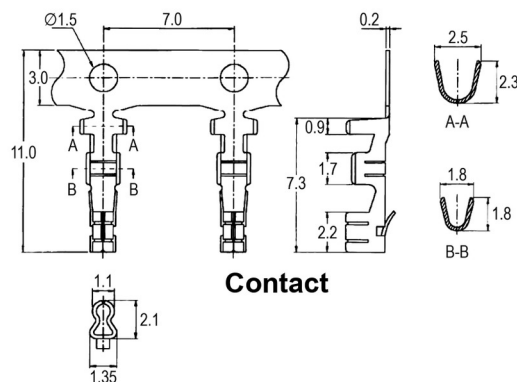
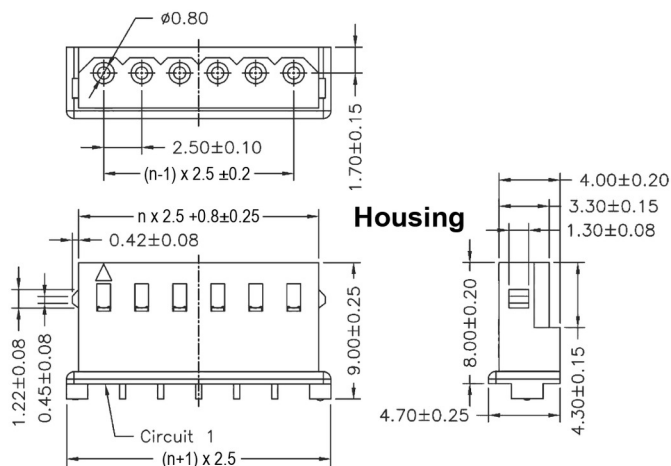
Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,50mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.50mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundstift Ø0,70mm, Kupferlegierung <i>Round pin Ø0.70mm, copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 24
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS



Series

575

Contacts*

08

02-15
01 (für Buchsenkontakte)
(for crimp contacts)

Type*

3

1 Buchsengehäuse
Housing
2 Buchsenkontakte
Crimp contacts
3 Stiftleiste gerade
Straight pin header
4 Stiftleiste gewinkelt
Right-angled pin header

Plating

50

50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich)
Tin plated (not necessary for housings)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

